

レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤

Acid Copper Plating Additives for Laser Through-hole Filling

トップルチナLTF

TOP LUCINA LTF

- 低膜厚でのスルーホールフィリングを実現
- 低膜厚化により配線の微細化に対応

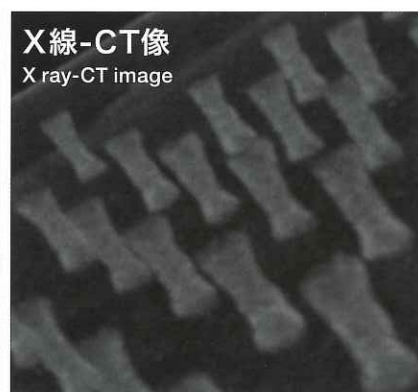
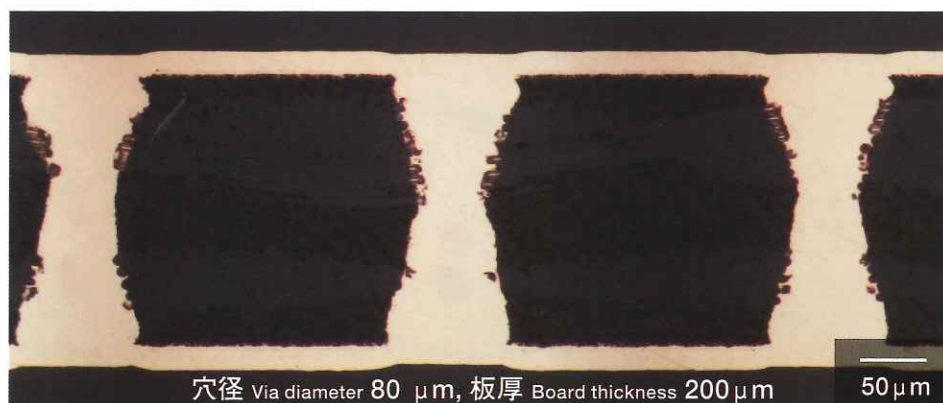
- Realize through-hole filling by thin thickness
- Applicable to fine circuit pattern by reducing thickness

- コア基板形成における工程簡略化が可能
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能

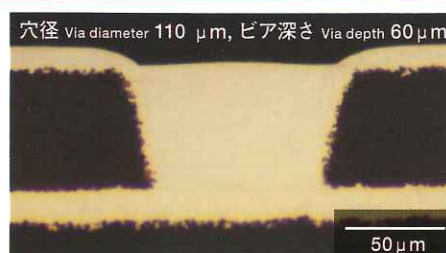
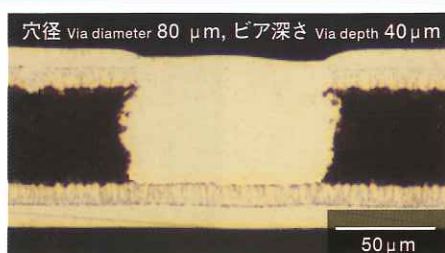
- By forming core boards, shorten treatment process
- Quantitative analyses are available for all additives

硫酸銅五水和物 $H_2SO_4 \cdot 5H_2O$	230 g/L
硫酸 H_2SO_4	70 g/L
塩化物イオン Cl^-	30 mg/L

電流密度 Current density	1.0 A/dm ²
めっき膜厚 Plating thickness	15 μm



ビアフィリングめっきにも適用可能 Applicable to via-filling



めっき膜厚 : 10 μm
Plating thickness